

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成25年7月25日(2013.7.25)

【公表番号】特表2012-531518(P2012-531518A)

【公表日】平成24年12月10日(2012.12.10)

【年通号数】公開・登録公報2012-052

【出願番号】特願2012-517584(P2012-517584)

【国際特許分類】

C 23 F 1/00 (2006.01)

C 23 F 1/30 (2006.01)

【F I】

C 23 F 1/00 1 0 2

C 23 F 1/30

【手続補正書】

【提出日】平成25年6月4日(2013.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材のパターン化方法であって、

自己組織化単層パターン化領域及び非パターン化領域を有する金属化表面を含む基材を用意する工程と、

前記基材を少なくとも300nm/分の速度で湿式エッティングして、前記非パターン化領域から金属を除去することにより金属パターンを形成する工程と、を含む、方法。

【請求項2】

前記湿式エッティングが、前記自己組織化単層パターン化領域を含む前記金属化表面を、バブリングガスにより振盪される液体エッチャント中に浸漬する工程を含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記自己組織化単層パターン化領域が、前記金属化表面上にマイクロコンタクト印刷されている、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

基材と、前記基材上に配置されたエッティングされたマイクロコンタクト印刷金属パターンとを含み、前記パターンが、少なくとも100ナノメートルの厚さと、少なくとも25cm²の範囲において少なくとも75%のパターン構造均一性とを有する、金属パターン化物品。